



(Taiwan)

EV Group Hybrid Bonding and Nanoimprint Lithography Solutions to be Highlighted at SEMICON TAIWAN 2023 – August 31, 2023



■ EVG將在SEMICON Taiwan 2023國際半導體展上，凸顯混合接合與奈米壓印微影解決方案

關鍵字：2023國際半導體展 SEMICON Taiwan 2023 奈米壓印微影 封裝技術 AR VR

瀏覽次數：307 | 新聞原文：f t g+ in

EV Group 新聞稿 發表於 2023年8月31日



圖：EVG將在SEMICON Taiwan 2023國際半導體展上，凸顯混合接合與奈米壓印微影解決方案

微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影設備領導廠商EV Group (EVG)，8月30日宣布將在下週於2023國際半導體展 (SEMICON Taiwan 2023) 中，凸顯其3D/異質整合及擴增實境 (AR) 波導管製造的全新發展，而這些進展是由該公司先進之晶圓到晶圓 (W2W) 與晶粒到晶圓 (D2W) 混合接合、檢測與奈米壓印微影 (NIL) 解決方案所促成，EVG將在2023國際半導體展中，發表以下演說：

探索奈米壓印微影、超穎透鏡與擴增實境/虛擬實境的綜效

(微機電系統暨感測器論壇-9月5日週二下午2點，台北南港展覽館一館5樓505ab室)

EVG業務發展總監Thomas Uhrmann，將針對奈米壓印微影的多功能性與近期成就提出概述，並聚焦在超穎透鏡與AR波導管的製造，以及該技術能力如何快速崛起中。他將深入探討如何透過將主製程技術、成熟的複製工藝和專用的光學材料相匹配，以實現這些精密結構的高效擴展。

3D與異質整合檢測的進展

(TechXPOT舞台-9月6日週二下午2點，台北南港展覽館一館4樓L1100單位)

EVG台灣資深應用暨技術部工程師Jason Li，將針對各種應用當前的疊層檢測需求提出概述，包括晶粒到晶圓、晶圓到晶圓以及新型封裝方法的晶粒轉移，如搭載自適應圖案的無光罩微影，瞭解並應對這些檢測需求，對於推進3D與異質整合技術及達成高效率且可靠的製造良率，至關重要。

藉由晶圓到晶圓接合實現次世代邏輯與記憶體製造：全面的觀點

(IC論壇-9月8日週五下午2點；台北南港展覽館一館4樓402室)

EVG技術執行總監Paul Lindner，將針對次世代記憶體與邏輯裝置相關的當前產業趨勢提出概述，並聚焦在3D整合如何推動全新的技術進步，其中包括結合搭疊接合與混合接合的討論，以及超薄薄層的分離技術，而該技術代表先進半導體裝置的全新微影微縮。

突破界線：探討用於3D-IC整合使用之混合晶片對晶圓與晶圓對晶圓接合

(異質整合全球高峰會-9月8日週五下午2:40；台北南港展覽館一館4樓401室)

Thomas Uhrmann博士，將針對晶圓到晶圓與晶粒到晶圓混合接合的當前產業趨勢與技術進展提出概述，包括關鍵技術差異化因素及整合場景。下一個技術轉型將導入通用的高密度互連技術，從而導致一個新的整合過程。整合流程的選擇將視互連密度、晶片大小、系統良率與成本等因素而定。

EVG異質整合解決方案

EVG的晶圓接合、微影與檢測解決方案，促成了先進封裝 (包括背照式CMOS影像感測器與其他3D-IC堆疊裝置)、微機電系統與化合物半導體等領域中技術創新的開發與量產。EVG有關異質整合與晶圓層級封裝的技術領先地位實例，包括下列近期的技術突破：應對3D裝置整合所需的混合接合；應對未來3D-IC封裝需求的晶圓接合對準技術；為先進封裝消除玻璃基板並促成薄層3D堆疊的紅外線雷射釋放技術；供扇出型晶圓級封裝 (FOWLP) 使用的無光罩曝光技術；以及支援晶圓級光學 (WLO) 的奈米壓印微影。

此外，EVG同時也與整個技術供應鏈的企業及研究團隊合作，以便為各式各樣的汽車、醫學、工業及家庭娛樂應用開發出量產的解決方案，來驅動半導體、感測器與光子學領域的創新。(1138個字；圖1)

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=19956>